

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月23日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2024年1-9月计提信用及资产减值准备的议案》

公司依据实际情况进行信用及资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提信用及资产减值准备。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2024年1-9月计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024年10月29日